



2025年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2025年4月28日

上場会社名 レーザーテック株式会社 上場取引所 東
コード番号 6920 URL <https://www.lasertec.co.jp/>
代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 仙洞田 哲也
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 （氏名） 横川 久 TEL 045-478-7111
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無： 有
決算説明会開催の有無： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

（百万円未満切捨て）

1. 2025年6月期第3四半期の連結業績（2024年7月1日～2025年3月31日）

（1）連結経営成績（累計）

（％表示は、対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2025年6月期第3四半期	168,835	7.4	79,291	36.5	75,394	28.5	52,694	26.9
2024年6月期第3四半期	157,202	97.9	58,110	111.5	58,693	109.8	41,521	100.4

（注）包括利益 2025年6月期第3四半期 50,479百万円（20.4％） 2024年6月期第3四半期 41,913百万円（101.9％）

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年6月期第3四半期	584.27	583.77
2024年6月期第3四半期	460.40	460.02

（2）連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	％	円 銭
2025年6月期第3四半期	299,365	177,333	59.2	1,965.98
2024年6月期	271,288	151,315	55.8	1,677.55

（参考）自己資本 2025年6月期第3四半期 177,312百万円 2024年6月期 151,294百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年6月期	—	73.00	—	157.00	230.00
2025年6月期	—	115.00	—	—	—
2025年6月期（予想）	—	—	—	173.00	288.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

3. 2025年6月期の連結業績予想（2024年7月1日～2025年6月30日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
通期	240,000	12.4	104,000	27.8	104,000	26.8	74,000	25.3	820.52

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更： 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

② ①以外の会計方針の変更： 無

③ 会計上の見積りの変更： 無

④ 修正再表示： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2025年6月期3Q	94,286,400株	2024年6月期	94,286,400株
2025年6月期3Q	4,096,039株	2024年6月期	4,098,919株
2025年6月期3Q	90,189,153株	2024年6月期3Q	90,185,934株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー： 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

（決算補足説明資料の入手方法）

当社は、2025年4月28日（月）に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。
この説明会で使用する資料については、開催にあわせて当社ウェブサイトに掲載する予定です。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期の経営成績の概況	2
(2) 当四半期の財政状態の概況	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(セグメント情報等の注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(収益認識関係)	9
3. 補足情報	10
(1) 品目別生産実績	10
(2) 品目別販売実績	10

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期の経営成績の概況

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、地政学リスクや政策動向による景気減速が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が続きました。

当社グループの主要販売先である半導体業界においても、スマートフォンやパソコンを中心とした最終需要は軟調に推移した一方で、AI関連への投資は堅調に行われました。また、パワー半導体関連への投資は低調に推移しました。

半導体デバイスのさらなる高性能化に向けた技術開発が引き続き進められています。また、米国では半導体工場の新設・増設に関わる新たな投資の構想が発表されており、半導体製造装置市場も中長期的に成長を続けると見込まれております。

当第3四半期連結累計期間の売上高につきましては1,688億35百万円（前年同期比7.4%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が1,335億68百万円（前年同期比1.5%減少）、その他が42億14百万円（前年同期比84.7%増加）、サービスが310億52百万円（前年同期比61.3%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が792億91百万円（前年同期比36.5%増加）、経常利益が753億94百万円（前年同期比28.5%増加）、親会社株主に帰属する四半期純利益が526億94百万円（前年同期比26.9%増加）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

①財政状態

当第3四半期連結会計期間末における総資産は2,993億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ280億77百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が156億72百万円、仕掛品が73億30百万円、原材料及び貯蔵品が46億74百万円増加したことによるものであります。

負債につきましては、当第3四半期連結会計期間末残高は1,220億31百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億59百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が25億54百万円、流動負債のその他が23億40百万円、株式給付引当金が4億63百万円減少したものの、賞与引当金が43億53百万円、前受金が34億82百万円増加したことによるものであります。

株主資本にその他の包括利益累計額及び新株予約権を加えた純資産合計は1,773億33百万円となり、また自己資本比率は59.2%となりました。

②キャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ156億72百万円増加し、538億24百万円となりました。当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、445億3百万円の収入（前年同期比83.1%増加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益753億94百万円、前受金の増加額49億35百万円、賞与引当金の増加額44億1百万円などの収入要因が、法人税等の支払額282億20百万円、棚卸資産の増加額161億60百万円などの支出要因を上回ったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、20億25百万円の支出（前年同期比10.7%減少）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出18億80百万円によるものであります。

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、245億58百万円の支出（前年同期比6.1%増加）となりました。これは主に、配当金の支払額245億31百万円によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2025年6月期連結業績予想につきましては、2024年8月7日に公表した予想から変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	38,152	53,824
受取手形、売掛金及び契約資産	22,905	22,077
仕掛品	126,087	133,418
原材料及び貯蔵品	36,314	40,988
その他	8,573	6,556
貸倒引当金	△53	△21
流動資産合計	231,978	256,844
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	10,862	11,099
機械装置及び運搬具（純額）	2,233	4,553
工具、器具及び備品（純額）	1,078	1,357
リース資産（純額）	71	143
土地	13,146	13,146
建設仮勘定	776	243
有形固定資産合計	28,168	30,542
無形固定資産	4,245	2,903
投資その他の資産		
投資有価証券	1,320	757
退職給付に係る資産	72	—
繰延税金資産	5,209	8,002
その他	292	313
投資その他の資産合計	6,895	9,074
固定資産合計	39,309	42,521
資産合計	271,288	299,365

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (2025年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	11,514	11,639
未払法人税等	15,903	13,348
前受金	74,426	77,908
繰延収益	9,011	8,829
賞与引当金	177	4,530
役員賞与引当金	1,060	605
その他	6,191	3,850
流動負債合計	118,284	120,712
固定負債		
退職給付に係る負債	492	523
株式給付引当金	874	410
資産除去債務	248	252
その他	72	132
固定負債合計	1,688	1,319
負債合計	119,972	122,031
純資産の部		
株主資本		
資本金	931	931
資本剰余金	1,290	1,359
利益剰余金	146,500	174,663
自己株式	△976	△976
株主資本合計	147,744	175,977
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	828	436
為替換算調整勘定	2,748	923
退職給付に係る調整累計額	△27	△25
その他の包括利益累計額合計	3,549	1,334
新株予約権	21	21
純資産合計	151,315	177,333
負債純資産合計	271,288	299,365

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)
売上高	157,202	168,835
売上原価	80,390	72,035
売上総利益	76,812	96,800
販売費及び一般管理費	18,702	17,508
営業利益	58,110	79,291
営業外収益		
受取利息	42	100
受取配当金	7	7
為替差益	543	—
その他	19	136
営業外収益合計	613	245
営業外費用		
支払利息	10	12
為替差損	—	4,095
その他	19	33
営業外費用合計	29	4,141
経常利益	58,693	75,394
税金等調整前四半期純利益	58,693	75,394
法人税、住民税及び事業税	18,063	25,352
法人税等調整額	△891	△2,652
法人税等合計	17,171	22,700
四半期純利益	41,521	52,694
親会社株主に帰属する四半期純利益	41,521	52,694

(四半期連結包括利益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)
四半期純利益	41,521	52,694
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△58	△391
為替換算調整勘定	450	△1,825
退職給付に係る調整額	0	2
その他の包括利益合計	391	△2,214
四半期包括利益	41,913	50,479
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	41,913	50,479
非支配株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年7月1日 至 2024年3月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年7月1日 至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	58,693	75,394
減価償却費	3,476	3,349
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△16	△31
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,725	4,401
役員賞与引当金の増減額 (△は減少)	△5	△455
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	44	31
株式給付引当金の増減額 (△は減少)	615	△436
受取利息及び受取配当金	△50	△108
支払利息	10	12
為替差損益 (△は益)	98	3,972
売上債権の増減額 (△は増加)	1,268	△114
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△9,292	△16,160
仕入債務の増減額 (△は減少)	4,695	202
前受金の増減額 (△は減少)	△17,746	4,935
その他	3,593	△2,357
小計	48,110	72,636
利息及び配当金の受取額	50	99
利息の支払額	△10	△11
法人税等の支払額	△23,844	△28,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	24,306	44,503
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△1,764	△1,880
無形固定資産の取得による支出	△483	△142
差入保証金の差入による支出	△21	△2
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,269	△2,025
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△5,000	—
配当金の支払額	△18,127	△24,531
その他	△12	△27
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,140	△24,558
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,074	△2,246
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△29	15,672
現金及び現金同等物の期首残高	29,773	38,152
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,744	53,824

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループの主たる地域別、収益認識の時期別の収益の分解と主たる製品及びサービスとの関連は次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間（自 2023年7月1日 至 2024年3月31日）

(単位：百万円)

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他		
地域別				
日本	9,277	597	1,802	11,677
韓国	42,231	960	1,822	45,014
台湾	49,924	570	4,138	54,633
その他アジア	6,045	135	1,834	8,015
米国	17,348	17	8,292	25,659
欧州	10,840	—	1,363	12,203
合計	135,667	2,281	19,253	157,202
収益認識の時期				
一時点で移転される財	126,257	2,239	11,326	139,824
一定期間にわたり移転されるサービス	9,410	41	7,927	17,378
合計	135,667	2,281	19,253	157,202

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

当第3四半期連結累計期間（自 2024年7月1日 至 2025年3月31日）

(単位：百万円)

	製品の販売		サービス	計
	半導体関連装置	その他		
地域別				
日本	11,957	1,860	2,346	16,163
韓国	25,181	66	3,804	29,051
台湾	46,999	283	8,549	55,832
その他アジア	9,089	2,004	2,707	13,801
米国	32,605	—	11,340	43,946
欧州	7,734	—	2,303	10,037
合計	133,568	4,214	31,052	168,835
収益認識の時期				
一時点で移転される財	122,724	4,115	15,791	142,632
一定期間にわたり移転されるサービス	10,843	99	15,260	26,203
合計	133,568	4,214	31,052	168,835

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

3. 補足情報

(1) 品目別生産実績

第3四半期連結累計期間における生産実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	135,784	164,912	21.5
	その他	2,972	3,912	31.6
	小計	138,757	168,825	21.7
サービス		19,253	31,052	61.3
合計		158,010	199,877	26.5

(注) 金額は販売価格で表示しております。

(2) 品目別販売実績

第3四半期連結累計期間における販売実績を品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品 目		前 期	当 期	対前年同四半期増減率
製 品		百万円	百万円	%
	半導体関連装置	135,667	133,568	△1.5
	その他	2,281	4,214	84.7
	小計	137,949	137,783	△0.1
サービス		19,253	31,052	61.3
合計		157,202	168,835	7.4